

深圳化金工艺3U沉金玻纤电路板批量生产加工厂家

产品名称	深圳化金工艺3U沉金玻纤电路板批量生产加工厂家
公司名称	深圳市捷科层峰电路有限公司
价格	.00/个
规格参数	工艺:化金 金厚:沉金3U 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井街道办新二庄村二路1号腾达翔科技园A栋1楼（注册地址）
联系电话	0755-27718513 17503031006

产品详情

玻璃纤维布基CCL有环氧树脂(FR-4、FR-5)，它是目前最广泛使用的玻纤电路板类型

另外还有其他特殊性树脂(以玻璃纤维布、聚基酰胺纤维、无纺布等为增加材料)：双马来酰亚胺改性三嗪树脂(BT)、聚酰亚胺树脂(PI)、二亚苯基醚树脂(PPO)、马来酸酐亚胺——苯乙烯树脂(MS)、聚氰酸酯树脂、聚烯烃树脂等。

按CCL的阻燃性能分类，可分为阻燃型(UL94-V0、UL94-V1级)和非阻燃型(UL94-HB级)两类板。

近一二年，随着对环保问题更加重视，在阻燃型CCL中又分出一种新型不含溴类物的CCL品种，可称为“绿色型阻燃cCL”。

随着电子产品技术的高速发展，对cCL有更高的性能要求。因此，从CCL的性能分类，又分为一般性能CCL、低介电常数CCL、高耐热性的CCL(一般板的L在150以上)、低热膨胀系数的CCL(一般用于封装基板上)等类型。

随着电子技术的发展和不断进步，对印制板基板材料不断提出新要求，从而，促进覆铜箔板标准的不断发展。目前，基板材料的主要标准如下

国家标准：我国有关基板材料的国家标准有GB / T4721—47221992及GB4723—4725—1992，中国台湾地区的覆铜箔板标准为CNS标准，是以日本JIs标准为蓝本制定的，于1983年发布。

国际标准：日本的JIS标准，美国的ASTM、NEMA、MIL、IPC、ANSI、UL标准，英国的Bs标准，德国的DIN、VDE标准，法国的NFC、UTE标准，加拿大的CSA标准，澳大利亚的AS标准，前苏联的FOCT标准，国际的IEC标准等；PCB设计材料的供应商，常见与常用到的就有：生益 \ 建滔 \ 国际等等